



NOTE (NOTES)

- 1 FINITURA (FINISH): STAGNATO 3.5µM (TIN PLATED 3.5µM).
- 2 FINITURA (FINISH): DORATO 0.4µM NELL'AREA DI CONTATTO E STAGNATO 2.5µM NELLA ZONA A SALDARE, SU 1.3µM DI NI. (DUPLEX PLATED 0.4µM GOLD IN CONTACT AREA AND 2.5µM TIN IN SOLDER AREA, OVER 1.3µM NICKEL).
- 3 FINITURA (FINISH): DORATO 0.8µM NELL'AREA DI CONTATTO E STAGNATO 2.5µM NELLA ZONA A SALDARE, SU 1.3µM DI NI. (DUPLEX PLATED 0.8µM GOLD IN CONTACT AREA AND 2.5µM TIN IN SOLDER AREA, OVER 1.3µM NICKEL).
- 4 MATERIALI (MATERIALS):
- TIN AND GOLD PLATED CONTACTS: BRASS

5 OBSOLETO (OBSOLETE)

- 6) SPECIFICA DI PRODOTTO : 108-20025 (PRODUCT SPECIFICATION : 108-20025)
- 7) Ø FORI RACCOMANDATO SU PCB: 1.1⁺⁰-0.2; 0.75 MIN. AMMESSO SOLO PER 2 POS. (RECOMMENDED PCB HOLES DIA: 1.1⁺⁰-0.2; 0.75 MIN. ADMITTED FOR 2 POS. ONLY)

58.5	53.34	5	280383-3	280383-2	280383-1	22
40.7	35.56	5	280382-3	280382-2	280382-1	15
33.1	27.94	5	280523-3	280523-2	280523-1	12
28.0	22.86		280381-3	280381-2	280381-1	10
25.4	20.32	5	280511-3	280511-2	280511-1	9
22.9	17.78		280380-3	280380-2	280380-1	8
17.8	12.70		280379-3	280379-2	280379-1	6
12.7	7.62		280378-3	280378-2	280378-1	4
7.7	2.54		280377-3	280377-2	280377-1	2
D	B		NUMERO (PART NUMBER) 3	NUMERO (PART NUMBER) 2	NUMERO (PART NUMBER) 1	NO. POS.

CUSTOMER DRAWING FOR REFERENCE ONLY / DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO
 THIS DRAWING IS UNPUBLISHED / RELEASE FOR PUBLICATION 19

TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) ± 0.3
 ANGOLI (ANGLES) ± 2°
 MATERIALI (MATERIALS) VEDERE NOTA (SEE NOTE) 4
 SCALA (SCALE) 5:1
TE TE Connectivity

DIS. G. CAMPIA 12 FEB 90 / DESCRIZIONE (DESCRIPTION) AMPMODU II HEADER ASS. IES, R. ANGLE, SINGLE ROW

S	STREAMLINING OF CONTACT BASE MATERIAL TO BRASS	SMT	25FEB 2013	APP.	
REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. (DR)	DATA (DATE)	APP. (APP.)	
LOC. SIZE NUMERO (DWG NO)			REV.	FOGLIO (SHEET)	
I A3 C - 280377			S	1 DI (OF) 1	

DISTRIBUZIONE (PRINT DIST.)